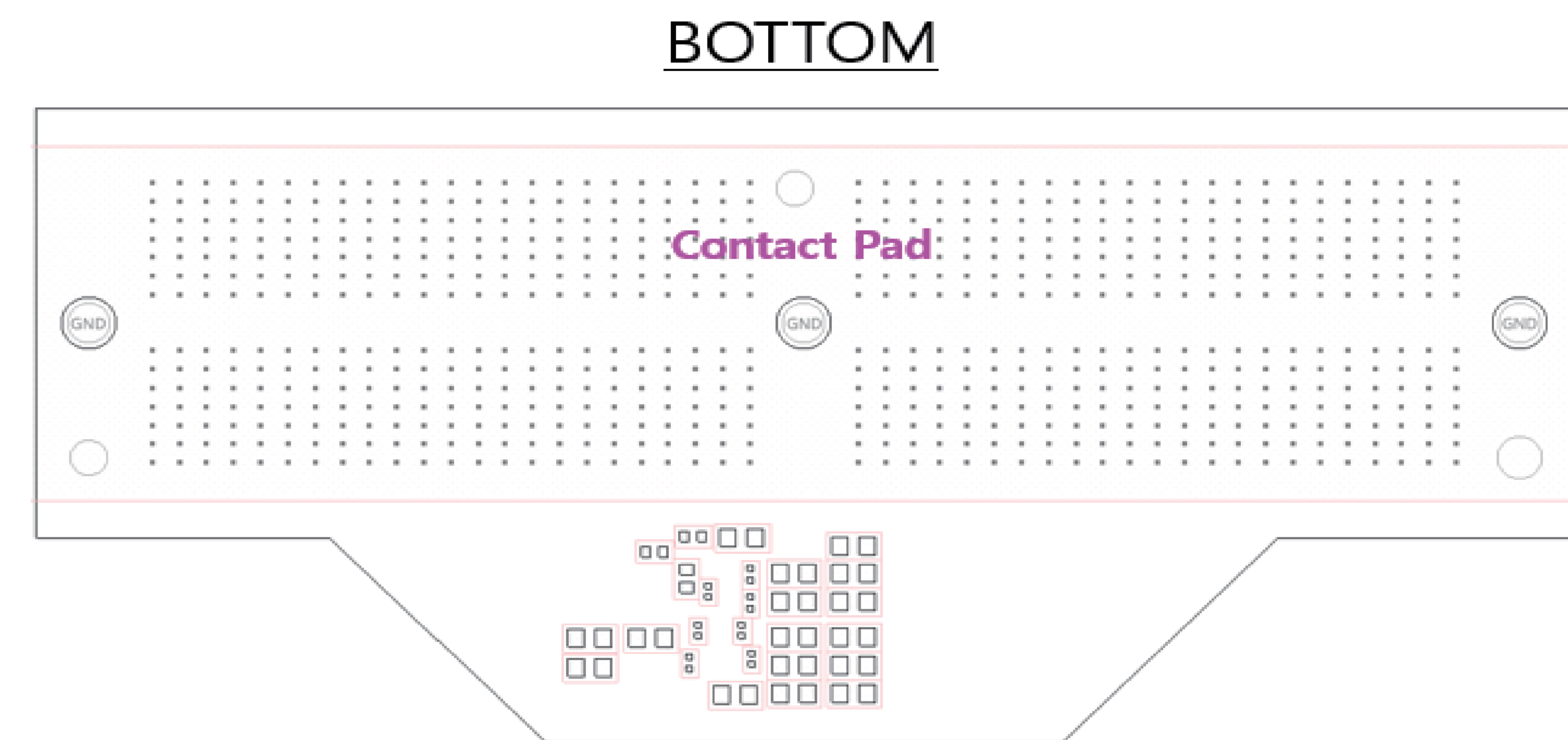
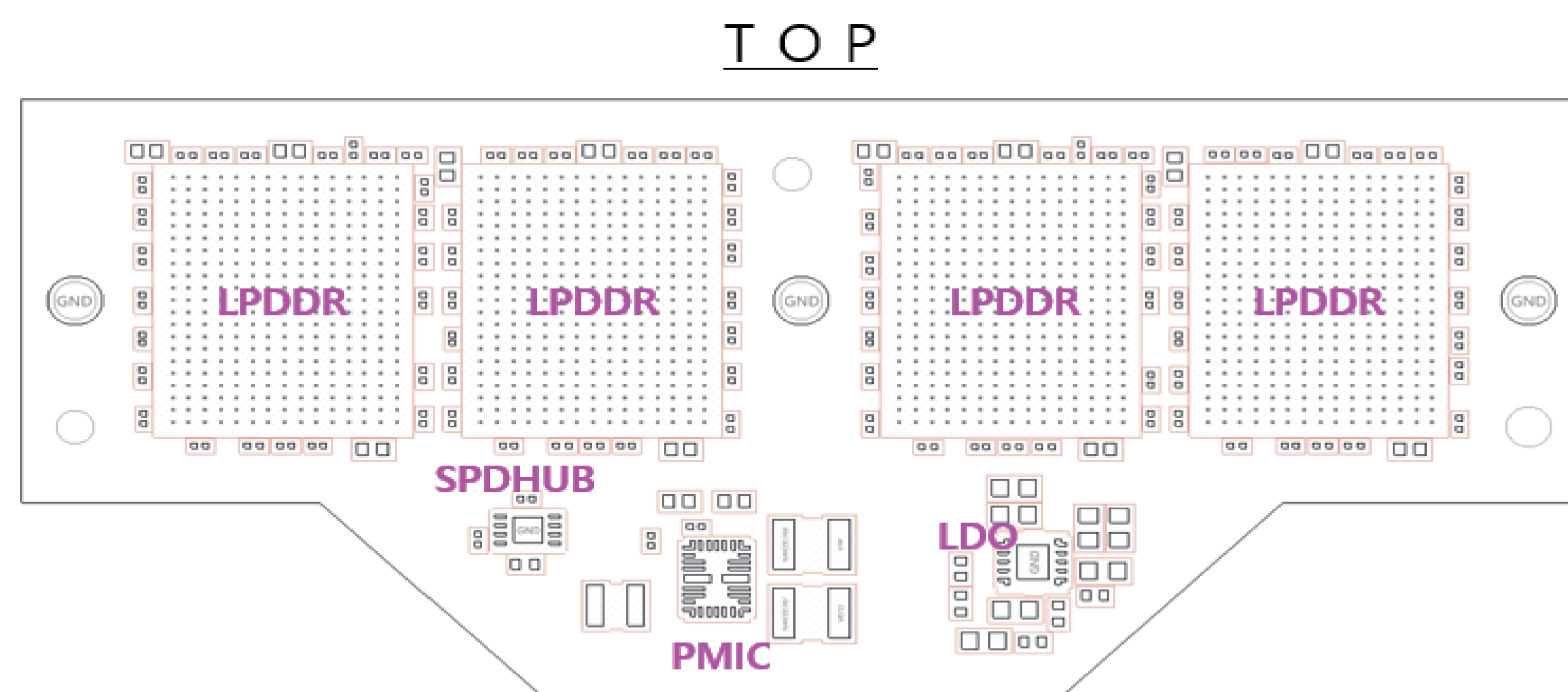


New Form-factor DIMM 개발에 따른 Test Infra 선제적 구축

CAMM(Compression Attached Memory Module)은 새로운 형태의 DRAM Module로, JEDEC 표준화를 추진 중 입니다.

Module PCB와 Connector로 구성되며 Screw로 Mainboard에 장착됩니다.

LPCAMM은 교체 가능한 LPDDR Solution이라는 점에서 관심 높으며, 내부적으로 가능성을 검토하여 개발 진행 중 입니다.



- 1. 교체 가능한 LPDDR Solution / 2. Routing 단순화 / 3. 공간 절약 / 4. 기존 대비 높은 내구성 / 5. EMI, RFI 차단



Intel 최신 Platform 기반 New Form-factor DIMM 특성을 선제적 대응 및 검증하기 위한 실장기 개발을 통해 Infra 및 품질 인증 체계 구축

SK하이닉스는 LPCAMM 제품에 대한 품질 안정성과 개발 검증을 위해 Intel의 RPL-P Platform을 선제적으로 개발 완료하였으며, 차세대 Platform 까지 개발 진행하여 완성도 높은 제품을 적기에 제품을 공급 할 수 있도록 기반을 마련하였습니다.